esp@cenet - Document Bibliography and Abstract

CERAMIC PASTE FOR FORMING CERAMIC CAPILLARY RIB

Patent Number:

JP2000185963

Publication date:

2000-07-04

Inventor(s):

TOYODA SEIJI; CHOKAI MAKOTO; KANDA YOSHIO; KUROMITSU YOSHIO GROUP 17

Applicant(s):

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Application Number: JP19980363186 19981221

Priority Number(s):

IPC Classification: C04B35/00; H01J9/02; H01J11/02; H01J17/16

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To form a ceramic capillary rib by a few processes simply and accurately without waste of material and to make a ceramic rib by keeping the shape of the capillary rib. SOLUTION. This ceramic paste is capable of forming a ceramic capillary rib by plastic deformation. This paste comprises 30-95 wt.% of glass powder or glass/ceramic mixed powder, 0.3-15 wt.% of a resin and 3-70 wt.% of a solvent. The solvent is a mixture of plural kinds of solvents, a plasticizer and a dispersant. Each boiling point of the solvents is different by >=30 deg.C. The paste is applied to give a paste film 11, a blade 12 is thrust into the paste film 11 in this state and the blade is moved relatively from the paste film 11 in a fixed direction. Consequently, the paste film 11 is plastically deformed to form, the ceramic capillary rib 13. The plural kinds of the solvents are successively vaporized during drying of the capillary rib to keep the shape of the capillary rib.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

http://l2.espacenet.com/espacenet/abstract?CY=ep&LG=en&PNP=JP200018596... 2003/07/09

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-185963 (P2000-185963A)

(43)公開日 平成12年7月4日(2000.7.4)

(51) IntCL'		識別記号	ΡI			テーマコード(参考)
C O 4 B	35/00	(p=0) 1 bez - 7	C04B	35/00	Y	4 G O 3 O
H01J	9/02		H01J	9/02	F	5 C 0 2 7
11013	11/02			11/02	В	5 C 0 4 0
	17/16			17/16		
					and the second of the second	v (A 0 EO

審査請求 有 請求項の数4 OL (全 9 頁)

(21)出顯器号	特關平10-363188	(71)出頭人	000006264
			三変マテリアル株式会社
(22) 出願日	平成10年12月21日(1998.12.21)		東京都千代田区大手町1丁目5番1号
		(72) 発明者	
			埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱
			マテリアル株式会社総合研究所内
		(72)発明者	鳥海 誠
		(, =, , =, ,	埼玉県大宮市北銀町1丁目297番地 三菱
			マテリアル株式会社総合研究所内
		(74)代理人	100085372
		(1401455)	弁理士 須田 正畿

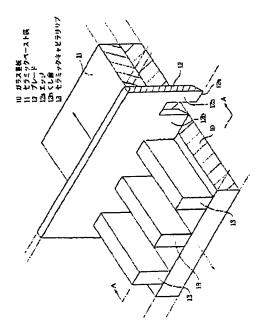
最終頁に続く

(54) 【免明の名称】 セラミックキャピラリリブを形成するためのセラミックペースト

(57)【要約】

【課題】少ない工程で材料の無駄なく、簡便にかつ精度 良くセラミックキャピラリリブを形成し、キャピラリリ ブの形状を保ってセラミックリブを形成する。

【解決手段】 塑性変形によってセラミックキャビラリリブを形成可能なセラミックペーストである。このペーストはガラス粉末又はガラス・セラミック混合粉末が30~95重量%と、簡脂が0.3~15重量%と、溶媒がる3~70重量%とを含む、溶媒が複数種類の溶剤と対象側と分散剤の混合物であり、これらの溶剤の各沸点が30で以上異なる。ペーストの塗布してペースト膜11にブレード12をつき刺し、このブレードをペースト膜11に対して相対的に一定方向に移動することにより、ペースト膜11を塑性変形してセラミックキャビラリリブ13が形成される。キャビラリリブの乾燥時に複数種類の溶剤が順次揮発し、キャビラリリブの形状を保つ、



【特許請求の範囲】

【謂求項1】 塑性変形によってセラミックキャビラリ リブを形成可能なセラミックペーストであって、

ガラス粉末又はガラス・セラミック混合粉末が30~9 5重量%と、樹脂が0.3~15重量%と、溶媒が3~ 70重量%とを含み、

可記溶媒が複数種類の溶剤と可塑剤と分散剤の混合物であり、可記複数種類の溶剤の各沸点が30℃以上異なることを特徴とするセラミックキャピラリリブを形成するためのセラミックペースト。

【請求項2】 塑性変形がセラミックペースト膜(11)に 所定のくし歯(12b)を有するブレード(12)をつき刺し、 前記ブレード(12)を前記ペースト膜(11)に対して相対的 に一定方向に移動することにより行われる請求項1記載 のセラミックペースト。

【請求項3】 請求項1又は2記載のセラミックペース トを用いて形成したセラミックキャピラリリブを乾燥焼 成してなるセラミックリブ。

【請求項4】 請求項3記載のセラミックリブを有する PDP。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、PDP (plasma d isplay panel: プラズマディスプレイパネル)、PALC (plasma addressed liquid crystal display) 等のFPD (flat panel display) の製造工程におけるセラミックキャピラリリブ (ceramic capillaryrib) を形成するためのセラミックペースト及びこのキャピラリリブから作られたセラミックリブ並びにこのセラミックリブを有するFPDに関するものである。

10002

【従来の技術】従来、セラミックリブは、図7に示すようにガラス基板1の上にガラス粉末を含むリブ形成用ペースト2を厚膜印刷法により所定のパターンで位置合わせをして多数回重わ塗りし、乾燥した後に焼成し、基板1上に所定の間隔をあけて作られている。このリブ8の高さ日は通常100~300μm、リブの幅Wは通常50~100μm程度であって、リブとリブで挟まれるセル9の広さ5は通常100~300μm程度である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の厚膜印刷法によるセラミックリブの形成方法では、リブの幅Wが50~100μm程度と比較的狭くかつ印刷後にペーストがだれ易いため、厚膜の一回壁りの厚さは焼成上がりで10~20μm程度に小さく抑えなければならない。この結果、この方法では高さ日が100~300μmのリブを作るために、厚膜を10~20回もの多くの回数重ね塗りする必要があり、その上重ね塗りした後のリブの高さ日をリブの幅Wで除した日/Wが1.5~4程度と大きいために、厚膜印刷時に十分に位置合わせ

をしても特度良くリブを形成しにくい欠点があった。本発明の目的は、少ない工程で材料の無駄なく、簡便にかつ特度良くセラミックキャピラリリブを形成でき、キャピラリリブの形状を保ってセラミックリブを形成し得るセラミックペーストを提供することにある。本発明の別の目的は、このキャピラリリブから作られたセラミックリブ並びにこのセラミックリブを有するFPDを提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】請求項1に係る発明は、 塑性変形によってセラミックキャビラリリブを形成可能 なセラミックペーストであって、ガラス粉末又はガラス ・セラミック混合粉末が30~95重量%と、樹脂が 0.3~15重量%と、溶媒が3~70重量%とを含 み、溶媒が複数種類の溶剤と可塑剤と分散剤の混合物で あり、これらの溶剤の名沸点が30℃以上異なることを 特徴とするセラミックペーストである。この請求項1に 記載されたセラミックペーストでは、上記のようにペー ストを配合することにより粘度が1000~500.0 〇〇cpsのペーストを得ることができ、基板上に形成 されたセラミックキャピラリリブのだれを抑制してセラ ミックキャピラリリブを精度良く形成する。なお、ペー ストの粘度は5、000~500、000cpsが好ま しく、10.000~300.000cpsが更に好ま しい。この所定の粘度を有するペーストに所定の外力を 加えると、ペーストが所望の形状のセラミックキャピラ リリブに変形し、上記外力を取り去ってもセラミックペ ーストは元に戻らずに、上記セラミックキャビラリリブ は変形した後の形状に保たれる。各沸点が30℃以上異 なる核数種類の溶剤を含ませることにより、キャビラリ リブの乾燥時に複数孫類の溶剤が順次揮発するため、キ ャピラリリブの形状が歪むことなくその形状を保ったま まセラミックリプを作製することができる。

【0005】請求項2に係る発明は、図」に示すように、請求項1に係る発明であって、塑性変形がセラミックペースト膜11に所定のくし歯12bを有するブレード12をつき刺し、ブレード12をペースト膜11に対して相対的に一定方向に移動することにより行うに引起である。この消求項2に記載されたセラミッ11に対した状態でブレード12bとペースト膜11に対して相対的に一定方向に移動することにより行われる。即に対応する質別のペースト膜11に対して相対的に一定方向に移動することにより行われる。即に対応する箇別のペーストがくし歯12bの隙間の形状に変形し、かつくし歯12bの隙間の形状に変形し、かつくし歯12bの隙間の形状に突がし、かつくし歯12bの隙間の形状に突がし、がつくし歯12bの隙間の形状に突がし、がつくし歯12bの隙間の形状に突がし、がつくし歯12bの隙間の形状に突がし、がつくし歯12bの隙間の形状に保たれる。この結果、基板10表面にセラミックキャビラリリブ13が形成される。

【0006】なお、本明細書で「セラミックキャヒラ リ」とは、本発明のガラス粉末又はガラス・セラミック 混合粉末と有機パインダと溶剤と可塑剤と分散剤を含む セラミックペーストを室布した後の大部分の有機パイン グと溶剤と可塑剤と分散剤が残存している状態をいう。 また「セラミックグリーン」とは、ガラス粉末又はガラ ス・セラミック混合粉末と樹脂と可塑剤と分散剤が残存 している状態で、溶剤の大部分が残存していない状態を

[0007]

【発明の実施の形態】次に本発明の第1の実施の形態を図面に基づいて説明する。図1に示すように、セラミックキャビラリリブ13は基板10の表面にセラミックペーストを塗布して形成されたセラミックペースト膜11に、ブレード12に形成されたくし歯12bをつき関し、ブレード12に形成されたくし歯12bをつき関し、ブレード12に形成されたくし歯12bをつき対することにより基板10表面に形成される。セラミックペーストは、ガラス粉末又はガラス・セラミック混合 份末と樹脂と溶媒(複数種類の溶剤と可塑剤と分放剤)とを含むペーストであり、ガラス粉末はSiO₂、ZnO、PbO等を主成分として、その軟化点が300℃~600℃であることが必要である。

【OOOS】ガラス・セラミック混合粉末とはSi O。、ZnO、PbO等を主成分とするガラス粉末と、 フィラーの役割を果すアルミナ、コージェライト、ムラ イト、フォルステライト等のセラミック粉末とを含むも のであり、このセラミック粉末は形成されるリプ13の 熱膨張係数をガラス基板10の熱脳残係数と均等にする ため、及び焼成後のセラミックリブの強度を向上させる ために混合される。セラミック粉末は60容積%以下が 好ましい。セラミック粉末が60容積%以上になるとり ブが多孔質になり好ましくない。なお、ガラス粉末及び セラミック粉末の粒径はそれぞれ0.1~30μmであ ることが好ましい、ガラス粉末及びセラミック粉末の粒 径がり、1μm未満であると凝集し易くその取扱いが煩 わしくなる。また、30μmを越えると後述するプレー ド12の移動時に所望のリブ13が形成できなくなる不 具合がある。

(0009) セラミックペーストは、ガラス粉末又はガラス・セラミック混合粉末を30~95重量%、樹脂を0.3~15重量%、溶媒(複数種類の溶剤と可塑剤と分散剤)を3~70重量%それぞれ配合する。また、90更量%、樹脂を0.5~3.5重量%、溶媒(複数種類の溶剤と可塑剤と分散剤)を7~20重量%それぞれ配合することが好ましい。ガラス粉末又はガラス・セラの混合粉末を30~95重量%の範囲に限定したのは、30重量%未満ではブレを用いて所定の形状のセラミックキャピラリリブを得るのが困難になり、95重量%を越えると基板表面にペーストを均一に塗布することが困難になるからである。また樹脂を0.3~15

重量%の範囲に限定したのは、0.3重量%未満ではブレードを用いて所定の形状のセラミックキャビラリリブを得るのが困難になり、15重量%を越えると基板表面にペーストを均一に选布することが困難になり、かつ不順、 では多いであるがあるからである。更に溶媒を3~70重量%の範囲に限定したのは、3重量%未満では基板表面にペーストを均一に装布することが困難になるからであり、70重量%を越えるとブレードを用いて所定の形状のセラミックキャビラリブを得るのが困難になるからである。とがを越えるとブレードを用いて所定の形状のセラミックキャビラリブを得るのが困難になるからである。とができ、基板上に形成されたセラミックキャビラリリブ13のだれを抑制してセラミックキャビラリリブ13のだれを抑制してセラミックキャビラリリブ13を精度良く形成することができる。

【0010】樹脂はパインダとしての機能を有し、熱分 解しやすく、溶剤に溶けて高粘度を有するポリマーであ って、エチルセルロース、アクリル又はボリビニルブチ ラールなどが挙げられる、溶剤としてはアルコール系、 エーテル系、芳香族系等の有機溶剤もしくは水が挙げら れる。有機溶剤はアルコール系及びエーテル系が好まし い。好ましいアルコールにはトリエチレングリコール、 αテレビネオール等が挙げられる。また好ましいエーデ ルにはジエチルエーテル等が挙げられる。複数種類の落 剤は沸点がそれぞれ30℃以上異なる。最も配合量の多 い溶剤の配合制合は80重量%以下が好ましく、60重 量%以下が更に好ましい。また最も配合量の少ない溶剤 の配合割合は10重量%以上が好ましく、30重量%以 上が更に好ましい、キャピラリリブ形成役の乾燥時にこ れらの溶剤が順次揮発し易くなるためである。これらの 溶剤を例示すれば、150℃前後の沸点の溶剤としてメ トキシエチルアセテート、2-エトキシエタノール等が あり、200℃前後の沸点の溶剤としてαテレビネオー ルがあり、300℃以上の沸点の溶剤としてテトラエチ レングリコール、1.5-ペンタンジオール等があるの で、これらを適宜組合せることにより、本発明の溶剤が 得られる。可塑剤としてはグリセリン、ジブチルフタン ート等が挙げられ、分散剤としてはベンゼンやスルフォ ン酸等が挙げられる、

【0011】セラミックペーストの基板10表面への塗布は、ローラコーティング法、スクリーン印刷法、ディップ法又はドクタブレード法等の既存の手段により行われる。基板10表面にペーストが塗布されペースト膜11をブレード12により塑性変形させてセラミックキャビラリリブ13を形成する。このペースト膜11の形成された基板10表面に接触させるブレード12には複数のくし触12bが等間隔にかつ同一方向に形成される。このブレード12はセラミックペーストとの反応やペーストに溶解されることのない金属、セラミ

ック又はプラスチック等により作られ、特に、寸法格度、耐久性の観点からセラミック若しくはFe、Ni.Co基の合金が好ましい。それぞれのくし歯12bの隙間はこのブレード12により形成されるセラミックキャピラリリブ13の断面形状に相応して形成される。図3及び図4に示すように、本実施の形態におけるブレード12は厚さ七が0.7mmのステンレススチールにより形成され、くし歯12bの隙間の深さhが300μmに形成される。

しょう マイとして いいけい 公共(生) 行りにしていかい

V

【0012】ここで、プレード12は、厚さもが0.0 1mm以上3.0mm以下であって、くし歯12bのヒ ッチをPとし、くし歯12bの隙間をw、その隙間の深 さをhとするとき、O.O3mm≤h≤1.Ommであ りかつw/P≦0.9の関係にあって、くし歯12bの ビッチPは50μm以上であることが好ましい。これら の条件を満たすブレード12により形成されたセラミッ クキャピラリリブ 1 3は、その後の乾燥及び焼成により 引き締り、所望のリブの隙間を有する微密なセラミック リブを得ることができる、また、くし歯12bの除間の 形状は図3に示すように方形状に形成する場合のみなら ず、最終的に作られるFPDの用途によりくし歯12b の隙間の形状を台形状又は逆台形に形成してもよい。く し歯12日の隙間の形状を台形にすれば、開口部を広く した用途に適したセラミックキャピラリリブ13を形成 することができ、くし歯12bの隙間の形状を逆台形に すれば、リブの頂部が広い面積で平坦化したセラミック キャピラリリブ13を形成することができる。

【〇〇13】図1に戻って、このように構成されたプレ ード12によるセラミックキャピラリリブ13の形成 は、プレード12のくし歯12bをベースト膜11につ き刺し、エッジ12aを基板10表面に接触させた状態 で、姜板10を固定して図1の実線矢印で示すようにブ レード12を一定方向に移動するか、又はブレード12 を固定して図1の破線矢印で示すように基板10を一定 方向に移動させてペースト膜11を塑性変形させること により行われる。即ち、上記移動により基板10表面に 途布されたペーストのプレード12のくし歯12bに対 応する箇所は、くし偏12bの隙間に移動するか若しく は掃き取られ、くし歯126の隙間に位置するペースト のみが基板10上に残存して基板10表面にセラミック キャピラリリブ13が形成される。くし歯の溝の深さが ベースト膜11の厚さより大きい場合にはプレード12 乂はガラス基板10を移動するときに掃き取られたペー ストが海に入り込みペースト膜11の厚さ以上の高さを 有するセラミックキャピラリリブ13を形成できる。こ のセラミックキャピラリリブ13を形成した後、大気中 100~200℃で10~30分間乾燥してセラミック グリーンリブを形成する。本発明ではセラミックペース トに各沸点が30℃以上異なる複数種類の溶剤を含ませ ているため、乾燥時に溶剤が一度に揮発せず、単一種類の溶剤を含んでいた場合と比較して、キャビラリリブ13の形状が良好に保たれてセラミックグリーンリブになる。続いて脱バイングのため大気中300~400℃で30分間~3時間加熱し、更に大気中520~580℃で10~30分間焼成することにより、図2に示す型崩れのないセラミックリブ14になる。このセラミックリブを用いて図示しないPDP、PAしC等のFPDを作製することができる。

【0014】上述のようにして基板10上に形成されたセラミックリブ14は、図2の拡大した円内に示すように、リブ14の高さをHとし、高さ(1/2) Hのところのリブ14の幅を W_c 、高さ(3/4) Hのところのリブ14の幅を W_c 及び高さ(9/10) Hのところのリブ14の幅を W_c とするとき、H、 W_c 、 W_c 及び W_c のそれぞれの(最大値-平均値)/平均値で表されるばらつきが5%以下であって、H $/W_c$ で表されるアスペクト比が1、5~10であることが好ましい。アスペクト比が1、5~10であることにより、極めて高精細なセラミックリブ14が得られる。

【0015】図5及び図6は本発明の第2の実施の形態を示す。図5及び図6において図1及び図2と同一符号は同一部品を示す。この実施の形態では、上記第1の実施の形態と同様に基板10の表面に形成されたセラミックペースト版11にブレード12のでし歯12bを到し、ブレード12のエッジ12aを基板10表面が定の高さ浮上した状態でブレード12又は基板10を一定方向に移動してペースト版11を要性変形させることにより、基板10表面にセラミックキャピラリ層22上にセラミックキャピラリリブ23が形成される。ペーストの成分分とで、ストの途布方法は上記第1の実施の形態と同一に構成される。

【0016】プレード12によるセラミックキャピラリ リブ23の形成は、図5に示すように、ブレード12の エッジ12aをペースト膜11を形成した進板10装面 から所定の高さ浮上した状態で整板10を固定して実線 矢印で示すようにブレード12を一定方向に移動する か、又はブレード12を固定して破線矢印で示すように **基板10を一定方向に移動させることにより行われる、** この移動により基板1.0表面から所定の高さまでのペー ストは基板表面上に残存してセラミックキャピラリ層で 2を形成し、このセラミックキャビラリ層22より上方 のペーストにおけるブレード12のくし歯126に対応 する箇所はくし歯12bの隙間に移動するか若しくは掃 き取られ、くし歯12日の隙間に位置するペーストのみ がセラミックキャビラリ眉22上に残存してセラミック キャピラリ層22上にセラミックキャピラリリブ23が 形成される。

【0017】次に上記セラミックキャピラリ層22及び

セラミックキャビラリリブ23から上記第1の天施の形態の方法と同様にして、図5に示す基板10上に絶縁層24が形成され、この絶縁層24上にセラミックリブ25が形成される。絶縁層24上に形成されたセラミックリブ25は、図6の拡大した円内に示すように、リブ25の高さをHとし、高さ(1/2)Hのところのリブ25の幅を W_c 、高さ(3/4)Hのところのリブ25の幅を W_c 及び高さ(9/10)Hのところのリブ25の幅を W_c とするとき、 H_c W_c 、 W_B 及び W_t のそれぞれの(最大値一平均値)/平均値で表されるばらつきが5%以下であって、H W_c で表されるアスペクト比が1、5~10であることにより、極めて高精細なセラミックリブ25が得られる。

[0018]

[実施例]次に本発明の実施例を比較例とともに詳しく 説明する。

【0019】一方、くし歯12bのピッチPが300μ

mであって、くし歯12bの隙間wが150μm、その 深さhが300um、厚さtが0.7mmのステンレス 網により形成されたブレード12を用意した(図3及び 図4)。ペーストを途布してから大気中室温下で3時間 放置した後、ガラス基板を固定したまま、このプレード 12のくし頃12bをペースト膜につき刺し、そのエッ ジ12aをガラス基板10に接触させた状態で、図1の 実線矢印で示す方向にブレード12を一定方向に移動し てペースト膜11を塑性変形させることにより、基板1 O表面にセラミックキャピラリリブ13を形成した。 【0020】<実施例2>平均粒径2μmのPb0-S i O₂ - B₂ O₂系ガラス粉末を50重量%と、セラミッ クフィラーとして平均粒径1μmのアルミナ粉末を50 重量%とを用意し、両者を十分に混合して混合粉末を作 製した。この混合粉末と樹脂としてのエチルセルロース と溶媒とを重重比で75/1/24の割合で配合し、十 分に混練してセラミックペーストを得た、溶媒は2-エ トキシエタノール、αテレビネオール及び1、5ーペンタンジオールの3種類の溶剤を重量比で2/2/1の割合で混合して調製した。このペーストを実施例1と同様にして実施例1と同じガラス基板上に塗布しペースト膜を形成した。大気中室温下で3時間放置した後、このペースト膜にブレードをつき刺して移動し、ペースト膜を要性変形させることにより、基板表面にセラミックキャビラリリブを形成した。

・【0021】<比較例1>図7に示すように、ソーダラ イム系ガラス基板1上にガラス粉末と有機パインダと溶 媒とを含む粘度が50、000cゃらのリブ形成用ベー スト2をスクリーン印刷法により所定のパターンで位置 合わせをして印刷し、150℃で10分間乾燥する工程 を12回線返して重わ塗りした。この重わ塗りはセラミ ックグリーンリブ2の高さHが200μmとなるように 設定した、上記リブ形成用ペーストとしては SIO_2 、 Zn O及びPb Oを主成分とするガラス粉末とA 1₂O₃ 粉末とを含む、また有機パインダとしてはエチルセルロ ースを用い、更に溶媒としてはダーテレビネオールを用 いた、これにより所定の間隔(セル9の広さS)をあけ てセラミックグリーンリブ2を形成した。次に基板1上 にセラミックグリーンリブ2が形成された構造体を大気 中で550℃で1時間熱処理することにより、蓋板↓上 に高さHが約170μmのセラミックリブ8を形成し

【0022】<比較試験及び評価>実施例1及び実施例 2の基板10に形成されたセラミックキャピラリリブ1 3を大気中150℃で20分間乾燥して溶媒を脱離させ ることによりセラミックグリーンリブ(図示せず)に し、更に脱バインダのために350℃で60分間加熱し た後に、大気中530℃で10分間焼成してセラミック リブ14とした。このように焼成して得られた実施例1 及び実施例2のセラミックリブ14のそれぞれ任意の1 00本と、比較例1で得られたセラミックリブ8の任意 の100本について、その高さH及び幅を以下のように それぞれ測定した。図2に示すように、実施例1.2及 び比較例1の基板上の任意の100本のセラミックリブ の幅の測定は、セラミックリブの高さをHとしたときの 高さ(1 \nearrow 2) 日のところのリブの幅 W_c 2 、高さ(3/4)Hのところのリブの幅W_kと、高さ(9/10) Hのところのリブの幅Wtとをそれぞれ測定することに より行った。またこれらの測定値の平均値を算出した 後、H、 W_t 、 W_t 及び W_t のそれぞれの(最大値又は最 小値-平均値)/平均値で表されるばらつきを算出し た。表1に実施例1.2の結果を比較例1の結果と対比 させて示す。

[0023]

【表1】

		实施例1	與施例 2	比較例1
H(100個)	(µ m)	151~153	181~184	161~182
W r (100個)	(µ m)	71~73	51~53	38~44
W×(100個)	(µm)	84~87	63~65	41~48
W a (100個)	(µm)	92~94	78~81	49~56
H (草均值)	(um)	152.22	182.59	171.52
W T (平身数)	(µm)	72.12	51.89	41.03
W 🗸 (早均值)	(µm)	85.46	64.05	44.47
W c (早乌帲)	(µm)	93.02	79. 55	52.54
Hのばらつ	£ (%)	+0.5/-0.8	+0.8/-0.9	+6.1/-6.1
W _τ のばらつ	≥ (%)	+1.2/-1.6	+2.1/-1.7	+7.2/-7.4
Wnのばらつ	≥ (%)	+1.8/-1.7	+1.5/-1.7	+7.9/-7.8
Woのばらつ	e (%)	+1.1/-1.1	+1.8/-1.9	+6.5/-6.7

【0024】表1から明らかなように、比較例1と比べて、実施例1及び実施例2では、セラミックキャビラリリブを形成した後、これを乾燥するときに3種類の溶剤が順次揮発するため、キャビラリリブの形崩れがなく、そのままの形状でセラミックグリーンリブができ、このグリーンリブから高さと幅のばらつきの小さいセラミックリブを基板上に形成できることが判った。

[0025]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、セ ラミックペーストを塑性変形させてセラミックキャピラ リリブを形成したので、所定の粘度を有するベーストに 所定の外力を加えると、ペーストが所望の形状のセラミ ックキャビラリリブに変形し、上記外力を取り去っても ペーストは元に戻らずに、上記セラミックキャピラリリ ブは変形した後の形状に保たれる。またセラミックペー ストがガラス粉末又はガラス・セラミック混合粉末が3 0~95重量%と、樹脂が0.3~15重量%と、溶媒 が3~70重量%とを含むように構成すれば、所定の粘 度のペーストを得ることができ、セラミックキャピラリ リブのだれを抑制できる。この結果、少ない工程で材料 の無駄なく、簡便にかつ精度良くセラミックキャピラリ リブを形成することができる。またこの塑性変形をセラ ミックペースト膜にくし歯をつき刺した状態でブレード をペースト限に対して相対的に一定方向に移動すること により行うと、ペースト膜のうちブレードのくし歯に対 応する箇所のベーストがくし歯の隙間に移動するか若し くは掃き取られるので、ペースト膜がくし歯の隙間の形 状に変形し、かつくし歯の隙間の形状に保たれる。この 結果、上記と同様に少ない工程で材料の無駄なく、簡便 にかつ特度良くセラミックキャピラリリブを形成するこ とができる。

【0026】上記溶媒に各沸点が30℃以上異なる複数 種類の溶剤を含ませることにより、キャピラリリブの 緑時に複数種類の溶剤が順次揺発するため、キャピラリ リブの形状が歪むことなくその形状を保ったままセラミ ックリブを作製することができる。本発明のセラミック キャピラリリブを乾燥焼成すれば、高精細なセラミック リブを形成でき、かつこのセラミックリブをFPDに利 用すれば、高品質のFPDが得られる。

【図面の簡単な説明】

■ 【図1】本発明第1実施形態のセラミックキャビラリリ プの形成状態を示す斜視図。

【図2】図1のA-A線断面におけるセラミックキャピラリリブを乾燥、加熱及び焼成することにより得たセラミックリブを示す断面図。

【図3】そのブレードの正面図、

【図4】図3のB-B線断面図。

【図5】本発明第2実施形態のセラミックキャビラリ層 付リブの形成状態を示す図1に対応する斜視図。

【図6】図5のB-B線断面におけるセラミックキャビラリ層付リブを乾燥、加熱及び焼成することにより得た 絶縁層付セラミックリブを示す図2に対応する断面図。

【図7】従来のセラミックリブの形成を工程順に示す断面図。

【符号の説明】

10 ガラス基板

:(7) 000-185963 (P2000-189JL8

11 セラミックペースト膜

12 ブレード

12a エッジ

126 くし歯

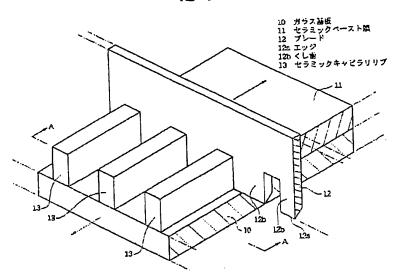
13、23 セラミックキャピラリリブ

14.25 セラミックリブ

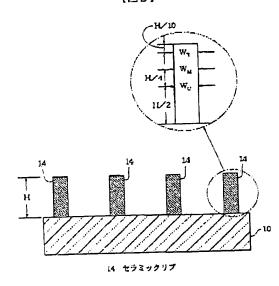
22 セラミックキャピラリ層

24 絶縁盾

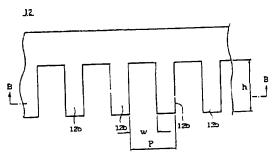
【図1】



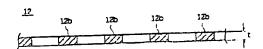
[図2]



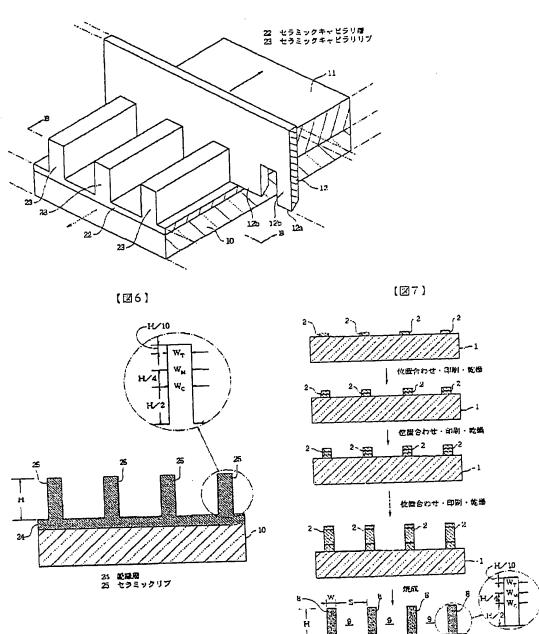
[23]



[24]



[図5]



フロントページの続き

(72)発明者 神田 義雄

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱

マテリアル株式会社総合研究所内

(72)発明者 黒光 祥郎

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱

マテリアル株式会社総合研究所内

Fターム(参考) 4GOSO AAS2 AAS7 AA40 AA67 EA12

CA07 GA17 GA20 HA04 HA09

HA18 HA25

5C027 AA09

5C040 GF18 GF19 JA02 JA11 JA20

JA22 JA28 KA11 KA17 LA17

MA24 MA26